

Datos OMNIMATE - Conectores USB USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bus serie universal 2.0 y 3.0 (SuperSpeed); los conectores tipo A cumplen los requisitos para alta resistencia y proporcionan una conectividad fiable.

- Hasta 5000 ciclos de enchufado
- Procedimientos de soldadura THT, THR o SMD
- Disponible en los tipos de diseño 180° (vertical/de pie) o 90° (horizontal)
- Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
- Capa de oro reforzada para protección mejorada contra la corrosión

Datos generales para pedido

Tipo	USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL
Código	1549730000
Versión	Conector para placa c.i., Conectores USB, Conexión por soldadura THT/THR, 2.00 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3 mm, Oro sobre níquel, azul, Bandeja (conjunto manual)
GTIN (EAN)	4050118356083
U.E.	100 Pieza
Embalaje	Bandeja (conjunto manual)

Datos OMNIMATE - Conectores USB USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14,65 mm	Anchura (pulgadas)	0,577 inch
Altura	18,9 mm	Altura (pulgadas)	0,744 inch
Altura construcción baja	14,95 mm	Profundidad	7,1 mm
Profundidad (pulgadas)	0,28 inch	Peso neto	2,46 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Especificaciones del sistema

Angulo de salida	180°	Anilla de apantallado	ninguno
Apantallamiento	Sí	Ciclos de enchufado	≥ 1500
Diámetro de la perforación (D)	0,7 mm	Familia del producto	Datos OMNIMATE - Conectores USB
LED	No	Longitud del terminal de soldadura (l)	3 mm
Material del apantallamiento	Latón	Modo de conexión	Tipo A, USB 3.0
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura THT/THR	Número de polos	8
Número de terminales de soldadura por polo	1	Paso en mm (P)	2 mm
Superficie de apantallado	niquelado	Tipo de conexión	Conector hembra
Tipo de protección	IP20	Velocidad de transmisión	5 Gbps

Propiedades eléctricas

Intensidad nominal	1,5 A	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	100 V AC
Resistencia de aislamiento	≥ 1000 MΩ	Tensión nominal	30 V

Datos del material

Materiales aislantes	LCP	Color	azul
Carta de colores (similar)	RAL 5012	Grupo de materiales aislantes	II
CTI	≥ 500	Resistencia de aislamiento	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material del contacto	Fósforo, bronce	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Estructura de capas del contacto del conector	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C		

Embalaje

Embalaje	Bandeja (conjunto manual)	Longitud de VPE	0 m
Anchura VPE	0 m	Altura de VPE	0 m

Datos OMNIMATE - Conectores USB USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

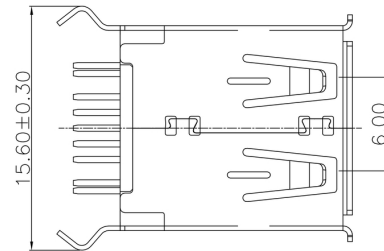
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Datos OMNIMATE - Conectores USB USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

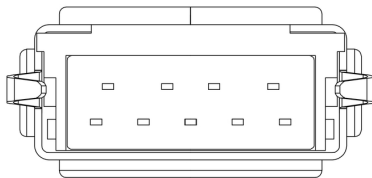
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

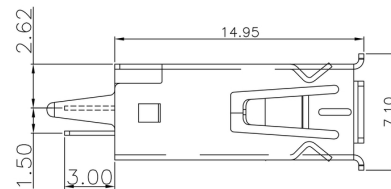
Dibujo acotado



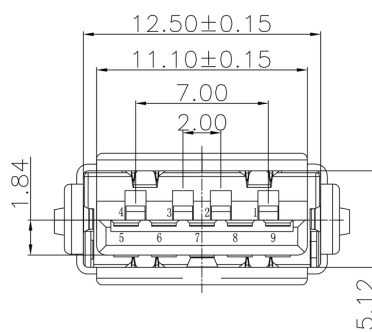
Dibujo acotado



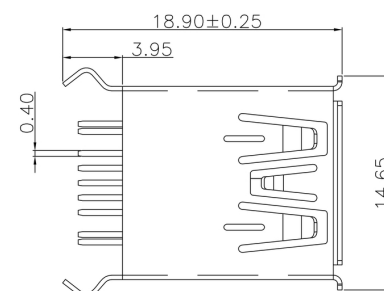
Dibujo acotado



Dibujo acotado



Dibujo acotado

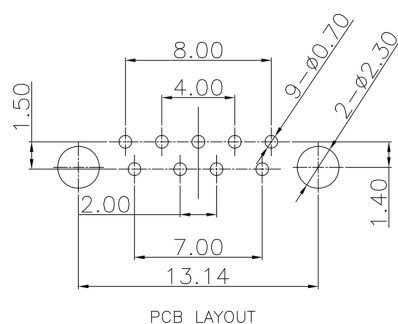


Datos OMNIMATE - Conectores USB USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Diseño de la placa de circuito impreso



Datos OMNIMATE - Conectores USB USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Dibujos

Leyenda

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.